

## 第1回

# 「バッチ晶析の基礎と応用」講習会

主催 分離技術会  
協賛 化学工学会晶析分科会

バッチ晶析は、化学工業、医薬品工業などにおいて広く使われています。その目的は結晶粒子の製造および分離精製です。バッチ晶析において常に問題となるのは、結晶粒径、結晶形状あるいは結晶多形の制御です。装置および操作設計も重要な課題です。

このたび、分離技術シリーズ「分かり易いバッチ晶析」をテキストとし講習会を開催することとしました。「分かり易いバッチ晶析」は結晶径制御を中心に、結晶形状制御、結晶多形制御および装置設計および操作設計法を、経験のない方にも理解できるように執筆出版したものです。講習会では、例題や最近の話題も含めて出来るだけやさしく講義します。

バッチ晶析の初心者ならびにこれからバッチ晶析を始めようとしている方はもちろん、バッチ晶析に携わっている多くの皆様方のご参加をお待ちしております。

日時 平成 22 年 11 月 26 日(金) 10:00 ~ 17:00

場所 日本大学理工学部 5 号館 (御茶ノ水) 524 教室

JR 総武線・中央線 御茶ノ水駅, 地下鉄千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩 3 分

案内図 <http://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/index.html>

対象 バッチ晶析の初心者および経験者

プログラム

### 1. シーディングを中心としたバッチ晶析の考え方 (10:00 ~ 12:30)

バッチ晶析は非常操作であって、結晶粒径分布、溶液濃度、温度などが時々刻々と変化します。そのため、バッチ晶析は複雑で工業的操作も難しいとされています。しかし、シーディングにより不要な核化が抑制され、操作も設計も簡単になります。本講では、シーディングを中心とした実用的なバッチ晶析法について解説します。

岩手大学名誉教授 久保田 徳 昭 氏

### 2. バッチ晶析の応用例と解析法 (13:30 ~ 16:00)

原理的に連続操作の困難な晶析法の中で、主に分離・精製を目的とする操作法として、昇華、圧力晶析、光学分割、層成長型の融液晶析などの応用例を中心に基本的な操作原理と、解析法を解説します。

東京農工大学教授 松岡 正 邦 氏

参加費 正会員・協賛団体会員 13,000 円、学生会員 5,000 円、同時入会 18,000 円、  
会員外 23,000 円 (含む資料代「分かり易いバッチ晶析」)

(ただし学生参加費には書籍「分かり易いバッチ晶析」は含みません)

参加費は前納にて郵便振替または下記銀行にお振り込みください。

・郵便振替:00100-9-21052 口座名 分離技術会

・みずほ銀行:神田支店 普通預金 1010899 口座名 分離技術会

申込先 参加ご希望の方は申込用紙にご記入の上、11月19日(金)までに下記事務局まで  
FAX・郵送または e-mail にてお申し込みください。

## 第 1 回 『バッチ晶析の基礎と応用』 講習会参加申込書

氏名 <small>(フリガナ)</small>			
勤務先			
所属			
所在地	〒 TEL _____ FAX _____ e-mail : _____		
送金内訳	銀行振込 ・ 郵便振替	請求書	要 ・ 不要
会員資格	正会員 ・ 維持会員 ・ 特別会員 ・ 学生会員 ・ 協賛団体会員 ・ 同時入会 ・ 会員外		

特に説明を望む事柄：	
質問事項：	

### 分 離 技 術 会

FAX : 044-935-2571

e-mail : jimur@sspej.gr.jp TEL : 044-935-2578

〒214-0034 川崎市多摩区三田 1-12-5-135